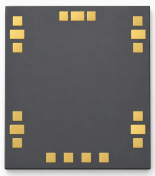
100–20000 MHz GaAs SP4T-MMIC-Schalter als Bare Die — IL –2 dB (typisch)

LCI-SW-100-20000-SP4T-D · 100–20000 MHz · GaAs SP4T-MMIC-Schalter als Bare Die.



Kennwerte der RF-Tabelle: Einfügedämpfung -2 dB (typisch); Isolation -50 dB (typisch). RF-Prüfbedingungen: TA = +25 °C.

Chipabmessungen: 1.6 × 1.9 × 0.1 mm.

VE (V) = -5; VA (V) = 0; VB (V) = 0; RF = RFin ↔ RFout1

VE (V) = -5; VA (V) = 3.3; VB (V) = 0; RF = RFin ↔ RFout2

VE (V) = -5; VA (V) = 0; VB (V) = 3.3; RF = RFin ↔ RFout3

VE (V) = -5; VA (V) = 3.3; VB (V) = 3.3; RF = RFin ↔ RFout4

RF-Kennwerte

TA = +25 °C

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Betriebsfrequenz	f	100	-	20000	MHz
Einfügedämpfung	-	-	-2	-	dB
Isolation	-	-	-50	-	dB
Eingangs-VSWR	-	-	1.3	-	-
Ausgangs-VSWR (leitend)	-	-	1.3	-	-
Ausgangs-VSWR (gesperrt)	-	-	1.3	-	-

Steuerspannungen

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Wert	Einheit
Ruhestrom der negativen Versorgung	-	-	0.0018	-	-	A
Eingangssteuerstrom	-	-	0.0003	-	TTL = +5 V	A
High-Eingangsspannung	-	3	-	5	-	V
Low-Eingangsspannung	-	0	-	0.4	-	V
Negative Versorgungsspannung	-	-	-	-	-5	V

Grenzwerte

Grenzwerte; keine Sollwerte für den Normalbetrieb.

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Maximale Eingangsleistung	-	-	-	27	dBm
Lagertemperatur	-	-65	-	150	°C

Grenzwerte

Grenzwerte; keine Sollwerte für den Normalbetrieb.

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Betriebstemperatur	-	-55	-	85	°C
Maximale Steuerspannung	-	-	-	6	V
Minimale negative Versorgungsspannung	-	-6	-	-	V

Chipabmessungen

Parameter	Wert	Einheit
Chipabmessungen	1.6 × 1.9 × 0.1	mm
Toleranz der Draufsichtkontur	±100	µm

Bondpad-Belegung

Anschlüsse	Symbol	mm
2	RFin	0.150 × 0.100
5	RFout1	0.150 × 0.100
8	RFout2	0.150 × 0.100
15	RFout3	0.150 × 0.100
18	RFout4	0.150 × 0.100
10, 13	VE	0.100 × 0.100
11	VA	0.100 × 0.100
12	VB	0.100 × 0.100
1, 3, 4, 6, 7, 9, 14, 16, 17, 19	GND	0.100 × 0.100

Aktueller Publikationsstand · 1.6 · 2026-11-12. Produktbeschreibung oder redaktionelle Inhalte wurden aktualisiert. Ersetzt Revision 1.5.

Integrationshinweise

VE (V) = -5; VA (V) = 0; VB (V) = 0; RF = RFin ↔ RFout1 VE (V) = -5; VA (V) = 3.3; VB (V) = 0; RF = RFin ↔ RFout2 VE (V) = -5; VA (V) = 0; VB (V) = 3.3; RF = RFin ↔ RFout3 VE (V) = -5; VA (V) = 3.3; VB (V) = 3.3; RF = RFin ↔ RFout4

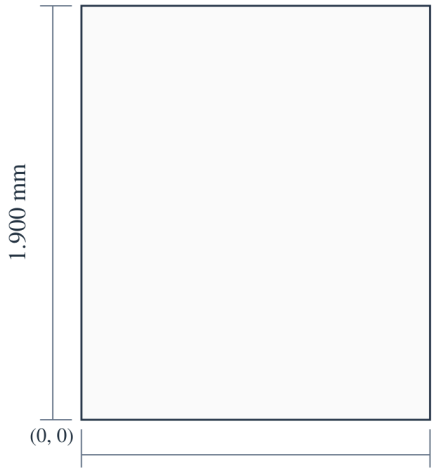
Anschluss der Bondpads

Die gekennzeichneten GND-Pads dienen als Test-Massepads.

Mechanische Maßzeichnung

Maßskizze mit Außenkontur und bemaßten Koordinaten in mm. Sie dient als Maßreferenz. Für Fertigung und Drahtbonden sind vollständige Zeichnungen erforderlich.

LCI-SW-100-20000-SP4T-D



X (mm)

RFin: 0.800

VE (13): 0.500

VB: 0.700

VA: 0.900

VE (10): 1.100

Y (mm)

RFout1 / RFout4: 1.570

RFout2 / RFout3: 0.440

1.600 × 1.900 × 0.100 mm

X, Y: ±0.100 mm

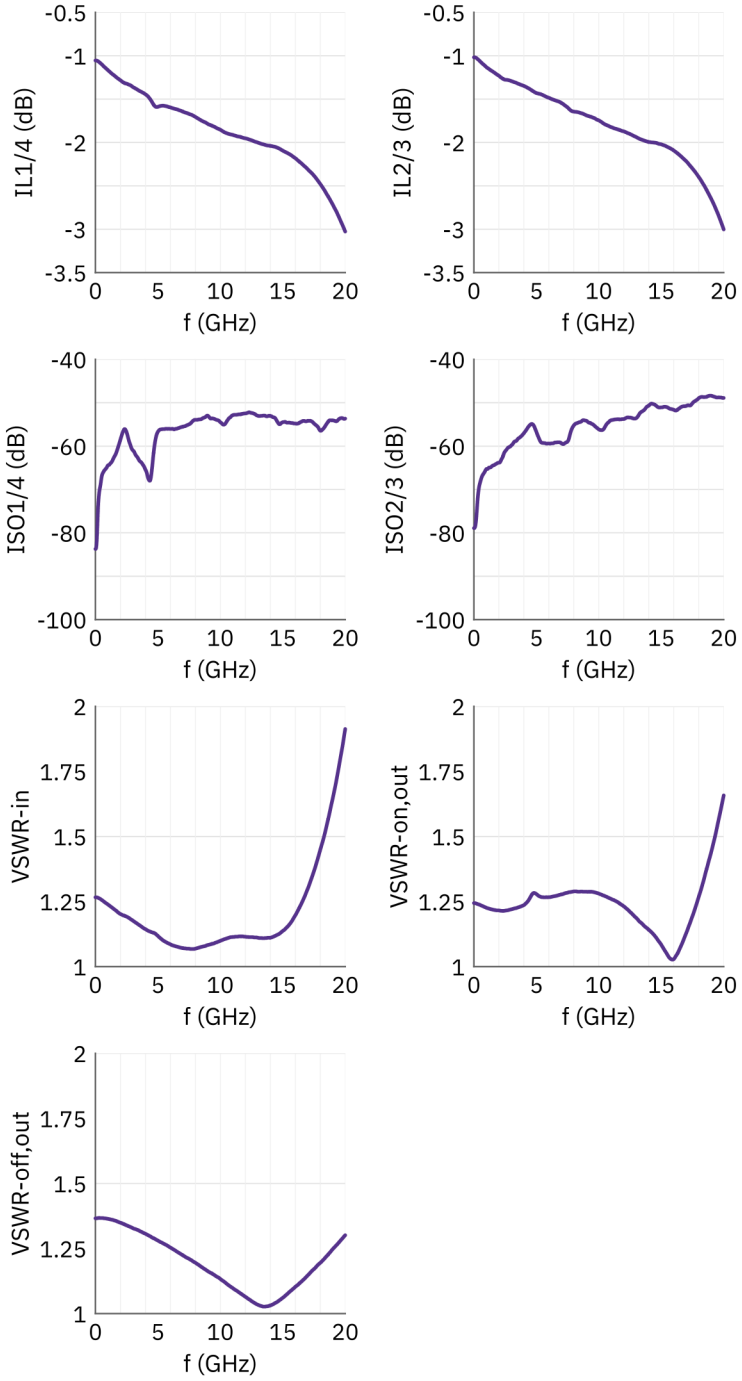
X → · Y ↑ · X, Y: mm

Kennlinien

Für jedes Diagramm gelten die jeweils angegebenen Betriebsbedingungen.

Ausgangsanpassung; Eingangsanpassung; Isolation; Einfügedämpfung.

Die ablesbaren Werte sind Näherungswerte.



Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.